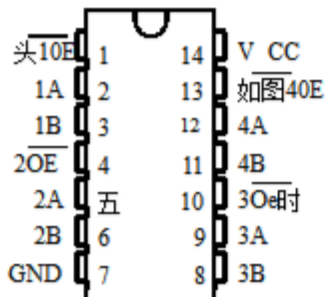


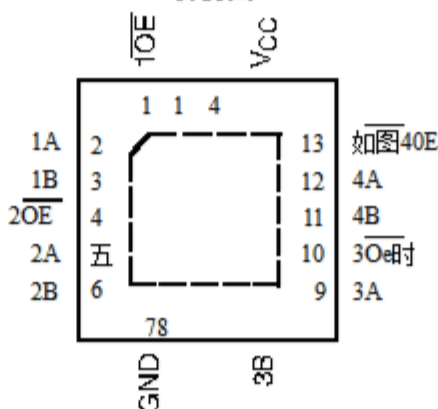
D 标准的125型引脚 (D, DB, DGV,
和PW包)

D 5Ω开关连接在两个端口之间
D TTL兼容输入电平

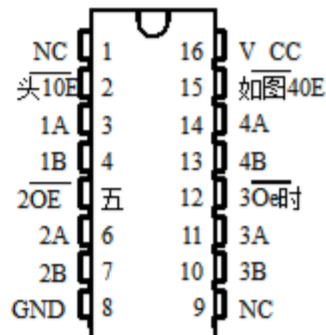
D, DB, DGV, 或PW包装
(顶视图)



RGY包装
(顶视图)



DBQ包装
(顶视图)



NC - 没有内部连接

描述/订购信息

SN74CBT3125四路FET总线开关具有独立的线路开关.每个开关都被禁用
当相关的输出使能(OE)输入为高时.

为确保上电或掉电时的高阻状态,OE应通过上拉连接至VCC
电阻器;电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力决定.

订购信息

T A.	包装†	订购 零件号	TOP-SIDE 打标
-40°C至85°C	QFN - RGY	磁带和卷轴	SN74CBT3125RGYR
	SOIC - D	管	SN74CBT3125D
		磁带和卷轴	SN74CBT3125DR
	SSOP - DB	磁带和卷轴	SN74CBT3125DBR
	SSOP (QSOP) - DB	磁带和卷轴	SN74CBT3125DBQR
	TSSOP - PW	磁带和卷轴	SN74CBT3125PWR
	TVSOP - DGV	磁带和卷轴	SN74CBT3125DGVR
			CU125

† 包装图纸, 标准包装数量, 热数据, 符号和PCB设计
准则可在www.ti.com/sc/package获得.

功能表 (每个总线开关)

INPUT OE	功能
大号	一个端口 = B端口
H	断开



请注意, 有关可用性, 标准保修和重要应用程序的重要通知
德州仪器半导体产品和免责声明出现在本数据表的末尾.

生产数据信息截至发布日期为止.
标准保修, 生产加工不一定包括
测试所有参数.



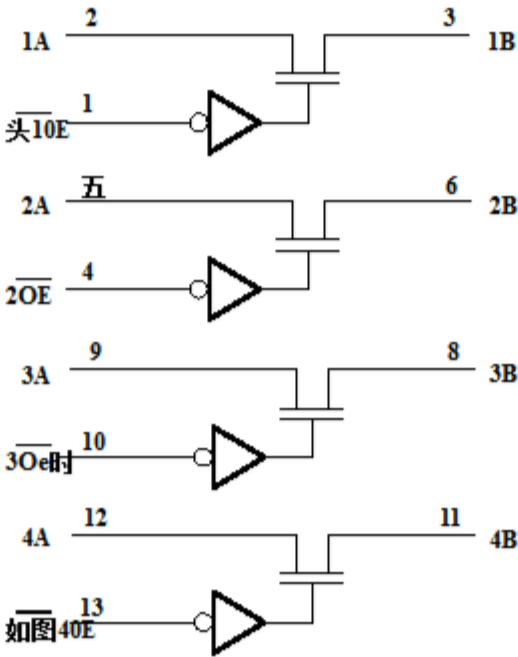
邮政信箱655303 • 达拉斯, 得克萨斯州75265

版权 ©2002, 德州仪器 (TI)

SN74CBT3125
四路FET总线开关

SCDS021I - 1995年5月 - 修订于2002年9月

逻辑图（正逻辑）



显示的引脚编号为D，DB，DGV，PW和RGY封装。

绝对最大额定值在运行自由空气温度范围（除非另有说明）†

电源电压范围，V _{CC}		-0.5V至7V
输入电压范围，V _I （见注1）		-0.5V至7V
连续通道电流		128毫安
输入钳位电流I _K （V _I /O < 0）		-50毫安
封装热阻抗，	θJA（见注2）：D包	86 °C / W
	（见注2）：DB包	96 °C / W
	（见注2）：DBQ包	90 °C / W
	（见注2）：DGV包	127 °C / W
	（见注2）：PW包	113 °C / W
	（见注3）：RGY包	47 °C / W
存储温度范围，T _{stg}		-65 °C至150°C

† 强调超出“绝对最大额定值”列出的可能会导致设备永久性损坏. 这些只是压力评级，和在这些或任何其他超出“推荐的工作条件”下所述条件的条件下，器件的功能操作不是默示. 暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性.

笔记： 1.如果观察输入和输出钳位电流额定值，可能会超出输入和输出负电压额定值.
2.封装热阻根据JESD 51-7计算.
3.封装热阻根据JESD 51-5进行计算.

推荐的操作条件（见注4）

	MIN	MAX	单元
V _{CC} 电源电压	4	5.5	V
V _{IH} 高电平控制输入电压	2		V
V _{IL} 低电平控制输入电压		0.8	V
T _A 操作自由空气温度	-40	85	°C

注4：器件的所有未使用的控制输入必须保持在V_{CC}或GND以确保器件正常工作. 请参阅TI应用报告，慢速或浮动CMOS输入的含义，文献编号SCBA004.



电气特性超过推荐的自由空气温度范围（除非另有说明）
另有说明）

参数	测试条件	MIN	TYP †	MAX	单元
V _{IK}	V _{CC} = 4 V, 我 = 18毫安			-1.2	V
我我	V _{CC} = 5.5 V, V _I = 5.5 V或GND			±1	μA
我 CC	V _{CC} = 5.5 V, 我 O = 0, V _I = V _{CC} 或GND			3	μA
ΔICC ‡ 控制输入	V _{CC} = 5.5 V, 一个3.4 V的输入, 其他输入在V _{CC} 或GND			2.5	嘛
C _i 控制输入	V _I = 3 V或0		3		pF的
C _{io} (OFF)	V _O = 3V或0, $\overline{OE}$ = V _{CC}		4		pF的
“关于”	V _{CC} = 4 V, TYP在V _{CC} = 4 V	V _I = 2.4V, 我 = 15毫安	16	22	Ω
	V _{CC} = 4.5V	V _I = 00 我 = 64毫安	五	7	
		我 = 30毫安	五	7	
		V _I = 2.4V, 我 = 15毫安	10	15	

† 所有典型值都在V_{CC} = 5 V（除非另有说明），T_A = 25°C.

‡ 这是指定的TTL电平而不是V_{CC} 或GND的 每个输入电源电流的增加。

§ 通过开关指示的电流，通过A和B端子之间的电压降来测量。通态电阻被确定通过两个（A或B）端子的较低电压。

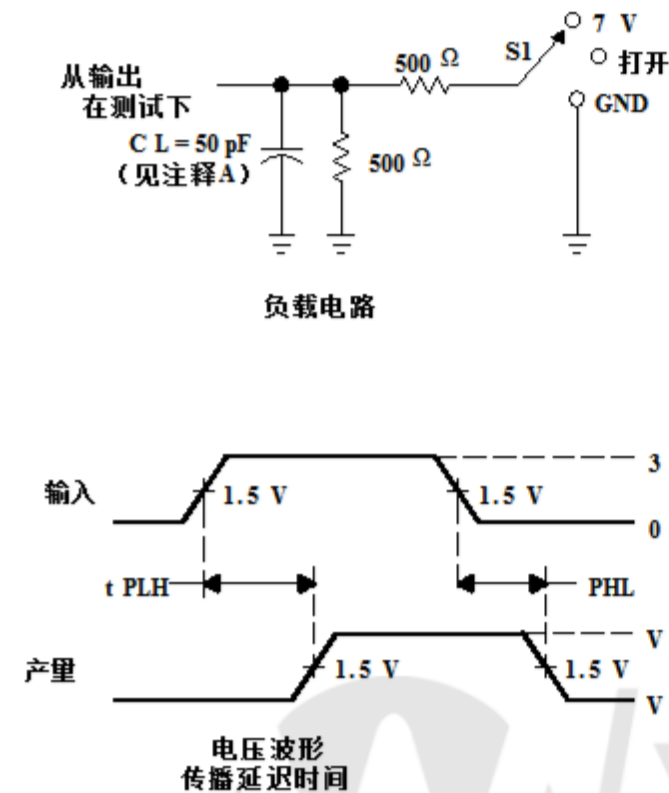
在推荐工作自由空气温度范围内的开关特性 C_L = 50 pF
（除非另有说明）（见图1）

参数	从 (INPUT)	至 (OUTPUT)	V _{CC} = 4 V		V _{CC} = 5V ±0.5 V		单元
			MIN	MAX	MIN	MAX	
t _{pd}	A或B	B或A		0.35		0.25	NS
t _{en}	$\overline{OE}$	A或B		6	1.6	5.4	NS
t _{dis}	$\overline{OE}$	A或B		5.1	1	4.7	NS

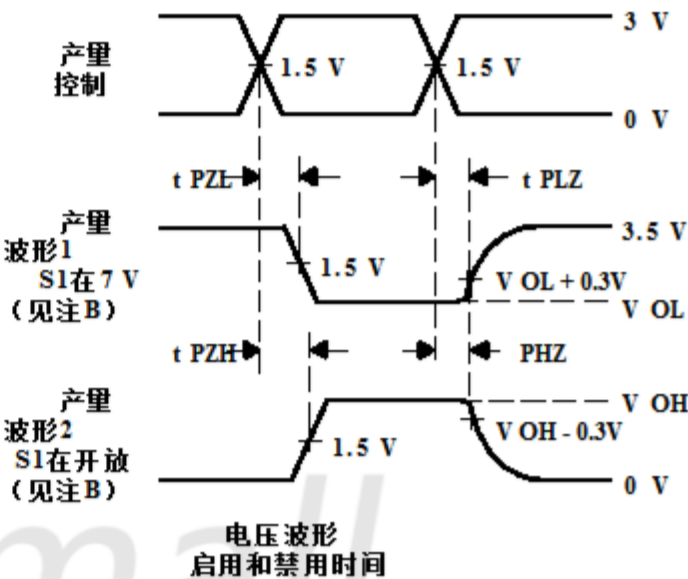
† 传播延迟是开关典型导通电阻和指定负载电容的计算RC时间常数，
当由理想电压源（零输出阻抗）驱动时。

www.wlxmall.com

参数测量信息



测试	S1
t _{pd}	打开
t _{PLZ} / t _{PZL}	7 V
t _{PHZ} / t _{PZH}	打开



注意：A. C_L 包括探头和夹具电容。

B. 波形1用于具有内部条件的输出，使得除输出控制禁止外，输出为低电平。

波形2用于具有内部条件的输出，使得除输出控制禁用外，输出为高电平。

C. 所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供：PRR

D. 输出每次测量一次，每次测量一次。

E. t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 与 t_{dis} 相同。

F. t_{PZL} 和 t_{PZH} 与 t_{en} 相同。

G. t_{PLH} 和 t_{PHL} 与 t_{pd} 相同。

H. 所有参数和波形不适用于所有设备。

图1. 负载电路和电压波形

包装信息

可订购设备	状态	(1) 包 类型	包 图	引脚包 数	生态计划 (2) 铅/球完成	MSL峰值温度 (3)
SN74CBT3125D	活性	SOIC	d	14	50 绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DBLE	已过时	SSOP	DB	14	TBD	打电话给TI打电话给TI
SN74CBT3125DBQR	活性	SSOP/ QSOP	DBQ	16	2500绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR
SN74CBT3125DBQRE4	活性	SSOP/ QSOP	DBQ	16	2500绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR
SN74CBT3125DBQRG4	活性	SSOP/ QSOP	DBQ	16	2500绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR
SN74CBT3125DBR	活性	SSOP	DB	14	2000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DBRE4	活性	SSOP	DB	14	2000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DBRG4	活性	SSOP	DB	14	2000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DE4	活性	SOIC	d	14	50 绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DG4	活性	SOIC	d	14	50 绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DGVR	活性	TVSOP	DGV	14	2000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DGVRE4	活性	TVSOP	DGV	14	2000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DGVRG4	活性	TVSOP	DGV	14	2000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DR	活性	SOIC	d	14	2500绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DRE4	活性	SOIC	d	14	2500绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125DRG4	活性	SOIC	d	14	2500绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125PW	活性	TSSOP	PW	14	90 绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125PWE4	活性	TSSOP	PW	14	90 绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125PWG4	活性	TSSOP	PW	14	90 绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125PWLE	已过时	TSSOP	PW	14	TBD	打电话给TI打电话给TI
SN74CBT3125PWR	活性	TSSOP	PW	14	2000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125PWRE4	活性	TSSOP	PW	14	2000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125PWRG4	活性	TSSOP	PW	14	2000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU等级-1-260C-UNLIM
SN74CBT3125RGYR	活性	VQFN	RGY	14	3000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR
SN74CBT3125RGYRG4	活性	VQFN	RGY	14	3000绿色 (RoHS & 无Sb / Br)	CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR

(1) 营销状况值定义如下:

ACTIVE: 推荐用于新设计的产品设备.

LIFEBUY: TI已经宣布该设备将停产, 终身购买期限已经生效.

NRND: 不建议用于新设计. 器件正在生产中以支持现有客户, 但TI不建议使用此部分一个新的设计.

预览: 设备已被宣布, 但尚未投入生产. 样品或提供或不提供.

停产: TI已停止生产该设备.

(2) 环保计划 - 计划的环保分类: 无铅 (RoHS), 无铅 (RoHS豁免) 或绿色 (RoHS和无Sb/Br) - 请检查

<http://www.ti.com/productcontent> 获取最新的可用性信息和其他产品内容详细信息.

待定: 无铅/绿色转换计划尚未定义.

无铅 (RoHS): TI的术语“无铅”或“无铅”是指符合当前RoHS要求的半导体产品

对于所有6种物质, 包括在均质材料中铅含量不超过0.1%的要求. 在哪里设计焊接

在高温下, TI无铅产品适用于特定的无铅工艺.

无铅 (RoHS豁免): 该组件具有RoHS豁免, 可用于1) 芯片与芯片之间使用的基于铅的倒装芯片焊料凸点封装, 或者2) 在芯片和引线框架之间使用的铅基芯片粘合剂. 该组件被视为无铅 (RoHS

兼容) 如上所述.

绿色 (RoHS& no Sb/Br): TI将“绿色”定义为无铅 (符合RoHS), 不含溴 (Br) 和锑 (Sb)

阻燃剂 (均相材料中Br或Sb不超过0.1%重量)

(3) MSL, Peak Temp. - 根据JEDEC行业标准分类的潮湿敏感度等级和峰值焊料

温度.

重要信息和免责声明: 本页面提供的信息代表了TI在当时的知识和信念

提供. TI根据第三方提供的信息来了解和信任, 对此不作任何表示或保证

这些信息的准确性. 正在努力更好地整合来自第三方的信息. TI已经采取并继续采取

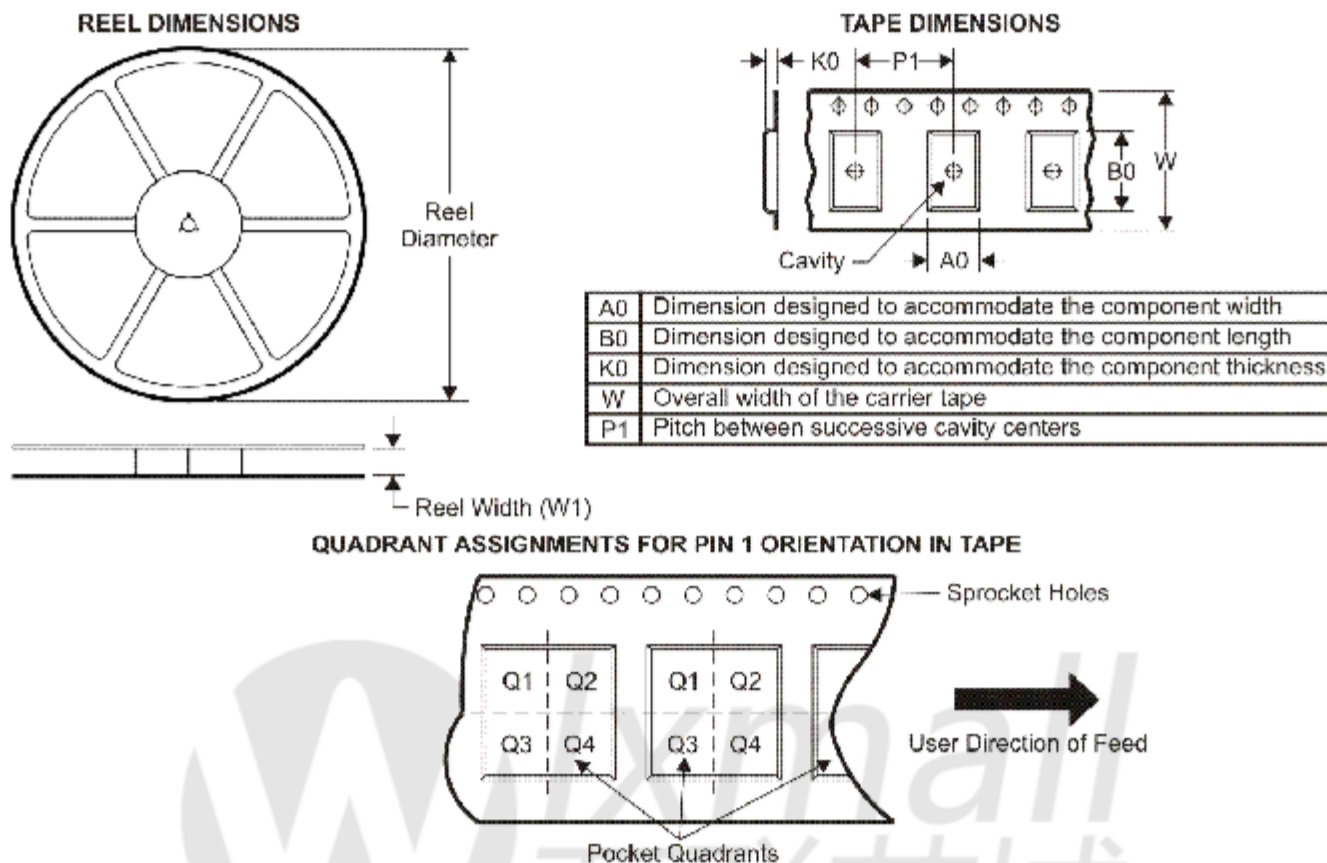
合理的步骤提供代表性和准确的信息, 但可能没有进行破坏性测试或化学分析

来料和化学品. TI和TI供应商认为某些信息是专有的, 因此CAS号码和其他限制

信息可能无法发布.

在任何情况下, 由于此类信息引起的TI责任, 均不得超过本TI出售TI器件的总购买价格
给客户每年.

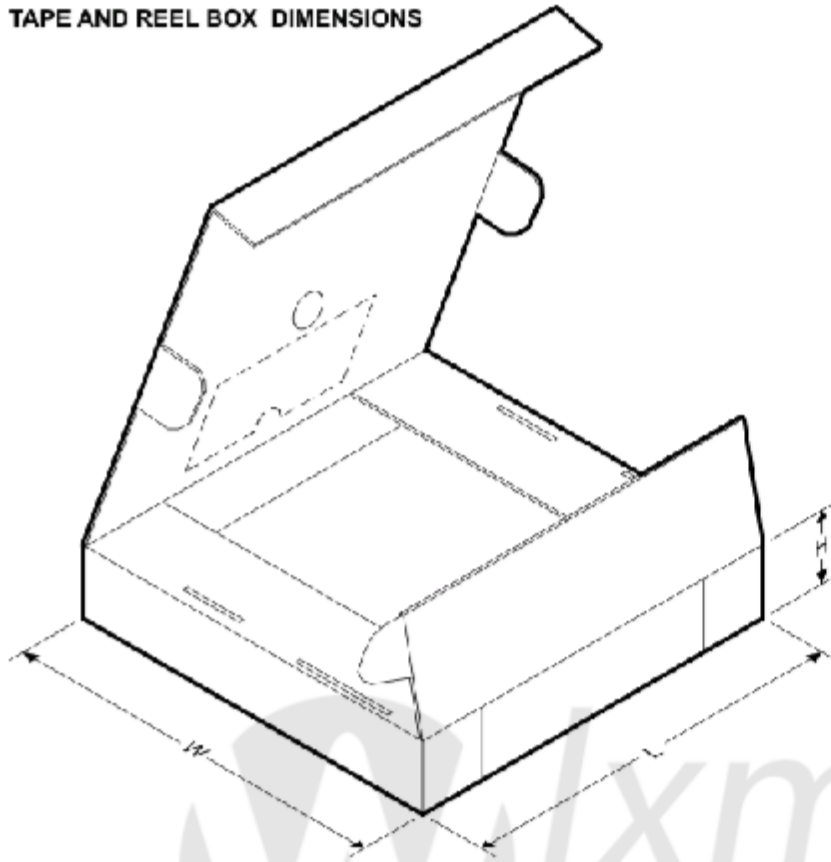
胶带和卷轴信息



*所有尺寸都是标称的

设备	包类型	包画	销	SPQ	卷轴直径 (毫米)	卷轴宽度 (毫米)	A0 (毫米)	B0 (毫米)	K0 (毫米)	P1 (毫米)	w ^ (毫米)	PIN1 象限
SN74CBT3125DBR	SSOP	DB	14	2000	330.0	16.4	8.2	6.6	2.5	12.0	16.0	Q1
SN74CBT3125DGVR	TVSOP	DGV	14	2000	330.0	12.4	6.8	4	1.6	8	12.0	Q1
SN74CBT3125DR	SOIC	d	14	2500	330.0	16.4	6.5	9	2.1	8	16.0	Q1
SN74CBT3125PWR	TSSOP	PW	14	2000	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8	12.0	Q1
SN74CBT3125RGYR	VQFN	RGY	14	3000	330.0	12.4	3.75	3.75	1.15	8	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



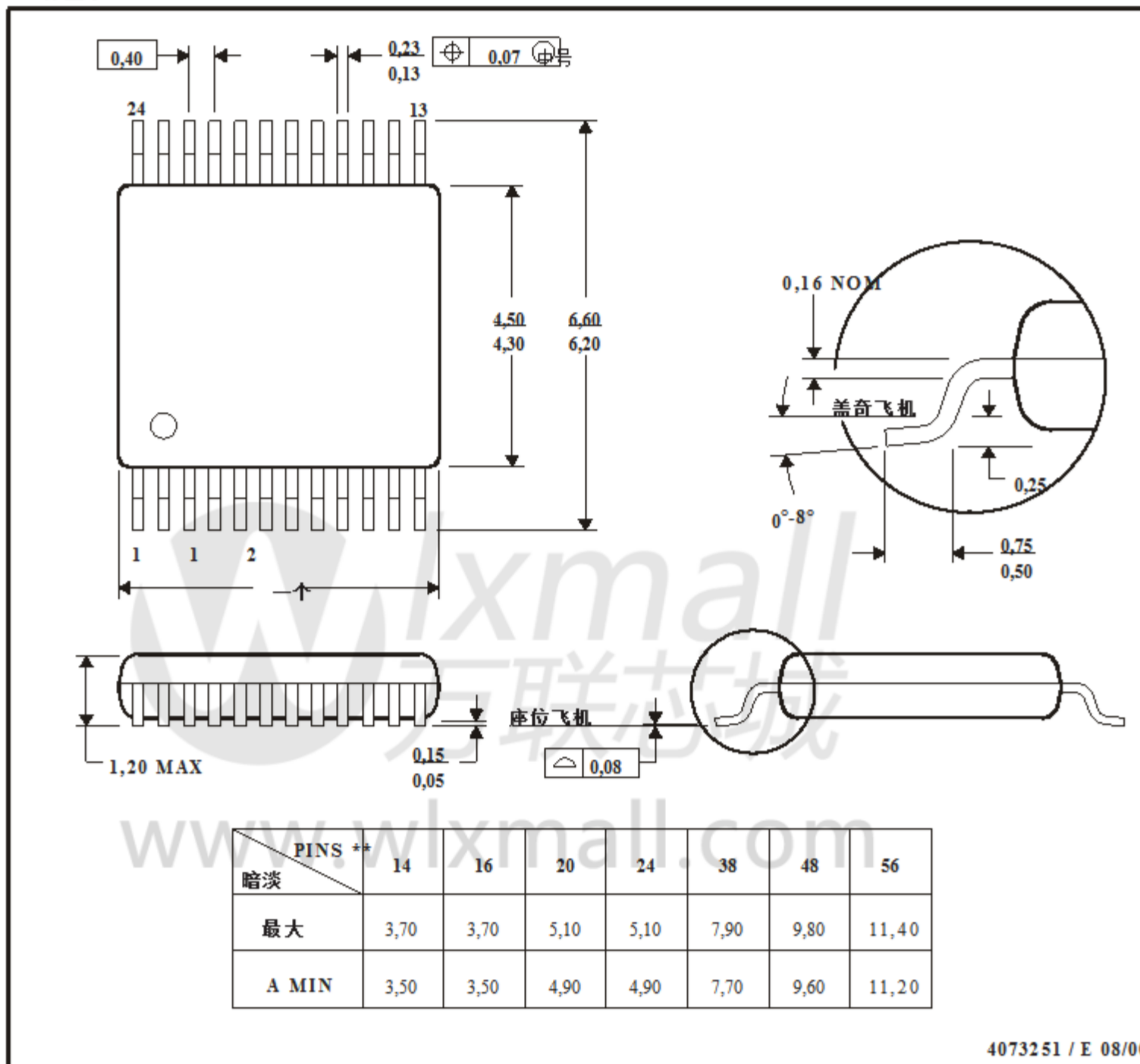
*所有尺寸都是标称的

设备	包装类型	包装图纸	销	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
SN74CBT3125DBR	SSOP	DB	14	2000	346.0	346.0	33.0
SN74CBT3125DGVR	TVSOP	DGV	14	2000	346.0	346.0	29.0
SN74CBT3125DR	SOIC	d	14	2500	346.0	346.0	33.0
SN74CBT3125PWR	TSSOP	PW	14	2000	346.0	346.0	29.0
SN74CBT3125RGYR	VQFN	RGY	14	3000	346.0	346.0	29.0

DGV (R-PDSO-G **)

塑料小外形

24针显示



注意事项: A. 所有线性尺寸均以毫米为单位。

B. 本图纸如有更改, 恕不另行通知。

C. 本体尺寸不包括模具闪光或突起, 每边不超过0.15。

D. 落在JEDEC内: 24/48针 - MO-153

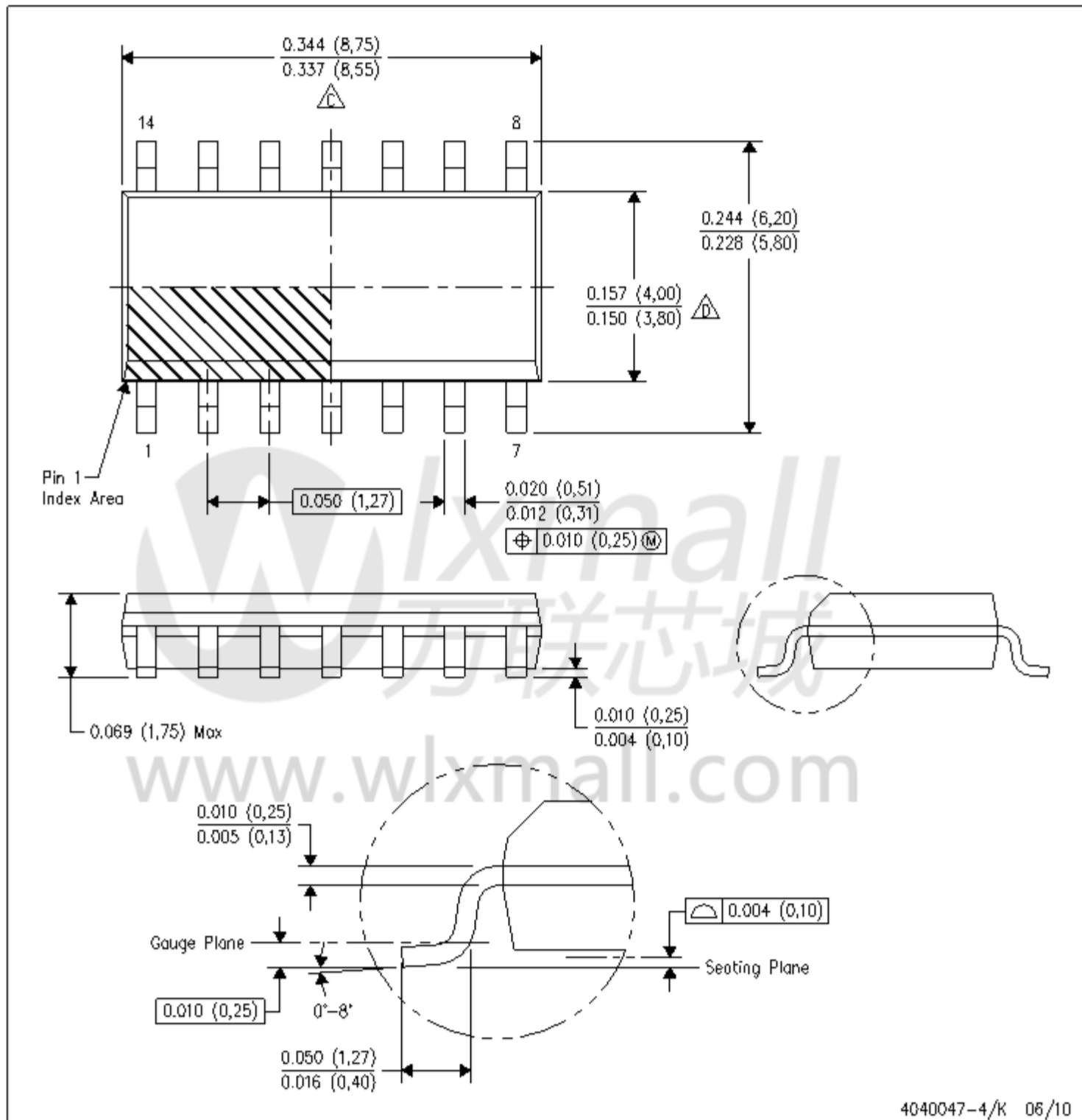
14/16/20/56 Pins - MO-194

TEXAS
INSTRUMENTS

邮政信箱655303 • 达拉斯, 得克萨斯州75265

D (R-PDSO-G14)

PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE

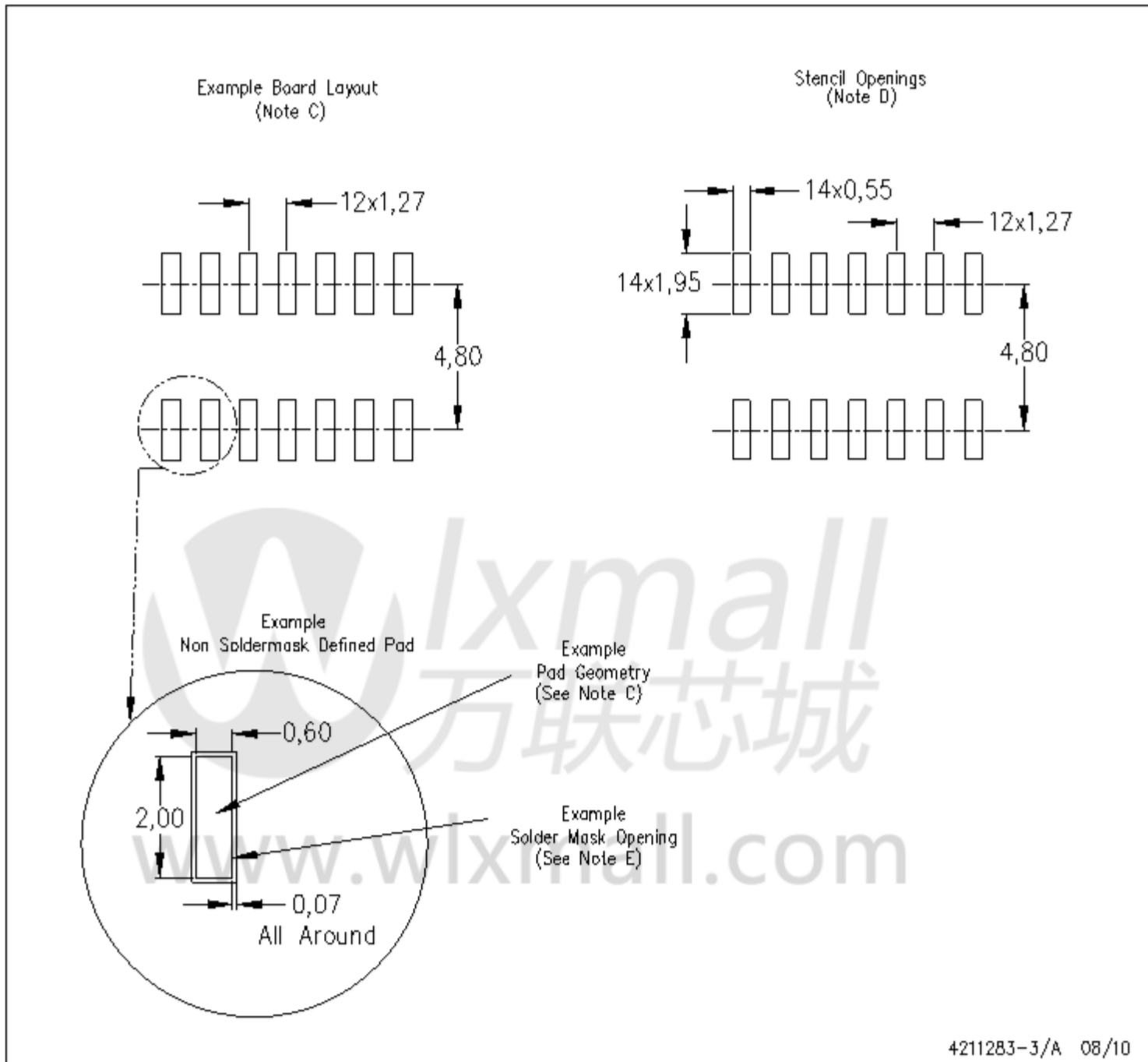


NOTES:

- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
- B. This drawing is subject to change without notice.
- C. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 (0,15) per end.
- D. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed .017 (0,43) per side.
- E. Reference JEDEC MS-012 variation AB.

D (R-PDSO-G14)

PLASTIC SMALL OUTLINE

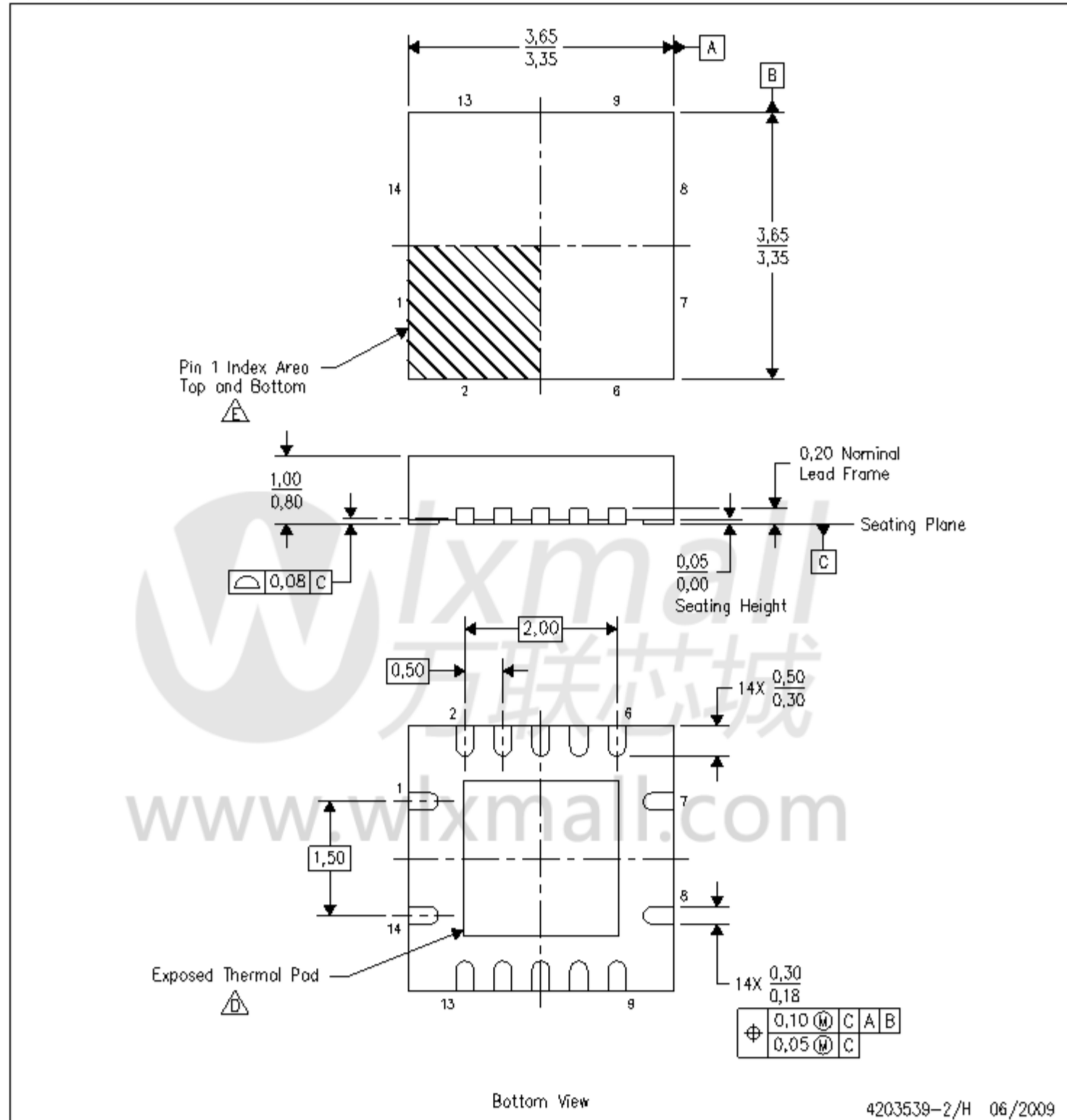


4211283-3/A 08/10

- NOTES:
- All linear dimensions are in millimeters.
 - This drawing is subject to change without notice.
 - Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs.
 - Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC-7525 for other stencil recommendations.
 - Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances between and around signal pads.

RGY (S-PVQFN-N14)

PLASTIC QUAD FLATPACK NO-LEAD



- NOTES:
- All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
 - This drawing is subject to change without notice.
 - QFN (Quad Flatpack No-Lead) package configuration.
 - The package thermal pad must be soldered to the board for thermal and mechanical performance. See the Product Data Sheet for details regarding the exposed thermal pad dimensions.
 - Pin 1 identifiers are located on both top and bottom of the package and within the zone indicated. The Pin 1 identifiers are either a molded, marked, or metal feature.
 - Package complies to JEDEC MO-241 variation BA.

THERMAL PAD MECHANICAL DATA

RGY (S-PVQFN-N14)

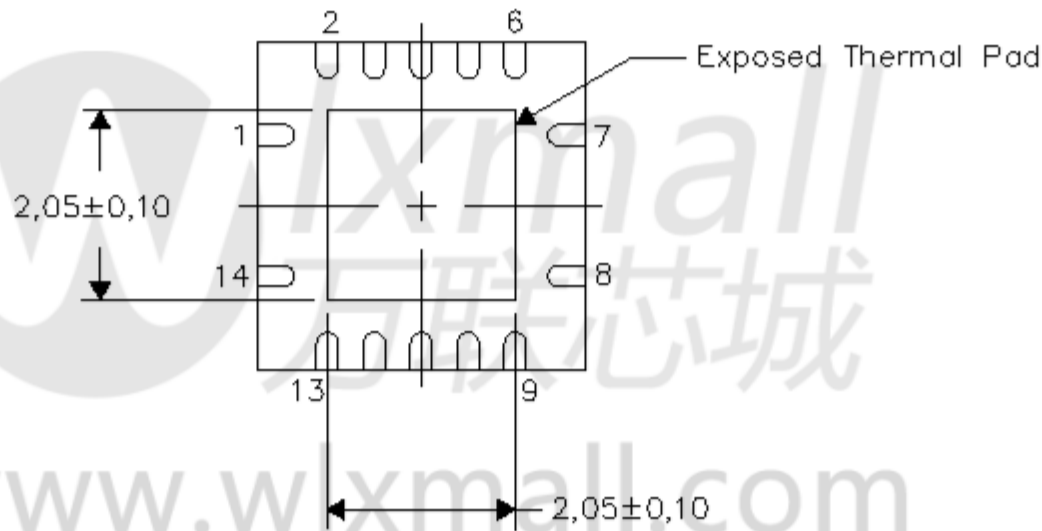
PLASTIC QUAD FLATPACK NO-LEAD

THERMAL INFORMATION

This package incorporates an exposed thermal pad that is designed to be attached directly to an external heatsink. The thermal pad must be soldered directly to the printed circuit board (PCB). After soldering, the PCB can be used as a heatsink. In addition, through the use of thermal vias, the thermal pad can be attached directly to the appropriate copper plane shown in the electrical schematic for the device, or alternatively, can be attached to a special heatsink structure designed into the PCB. This design optimizes the heat transfer from the integrated circuit (IC).

For information on the Quad Flatpack No-Lead (QFN) package and its advantages, refer to Application Report, QFN/SON PCB Attachment, Texas Instruments Literature No. SLUA271. This document is available at www.ti.com.

The exposed thermal pad dimensions for this package are shown in the following illustration.



Bottom View

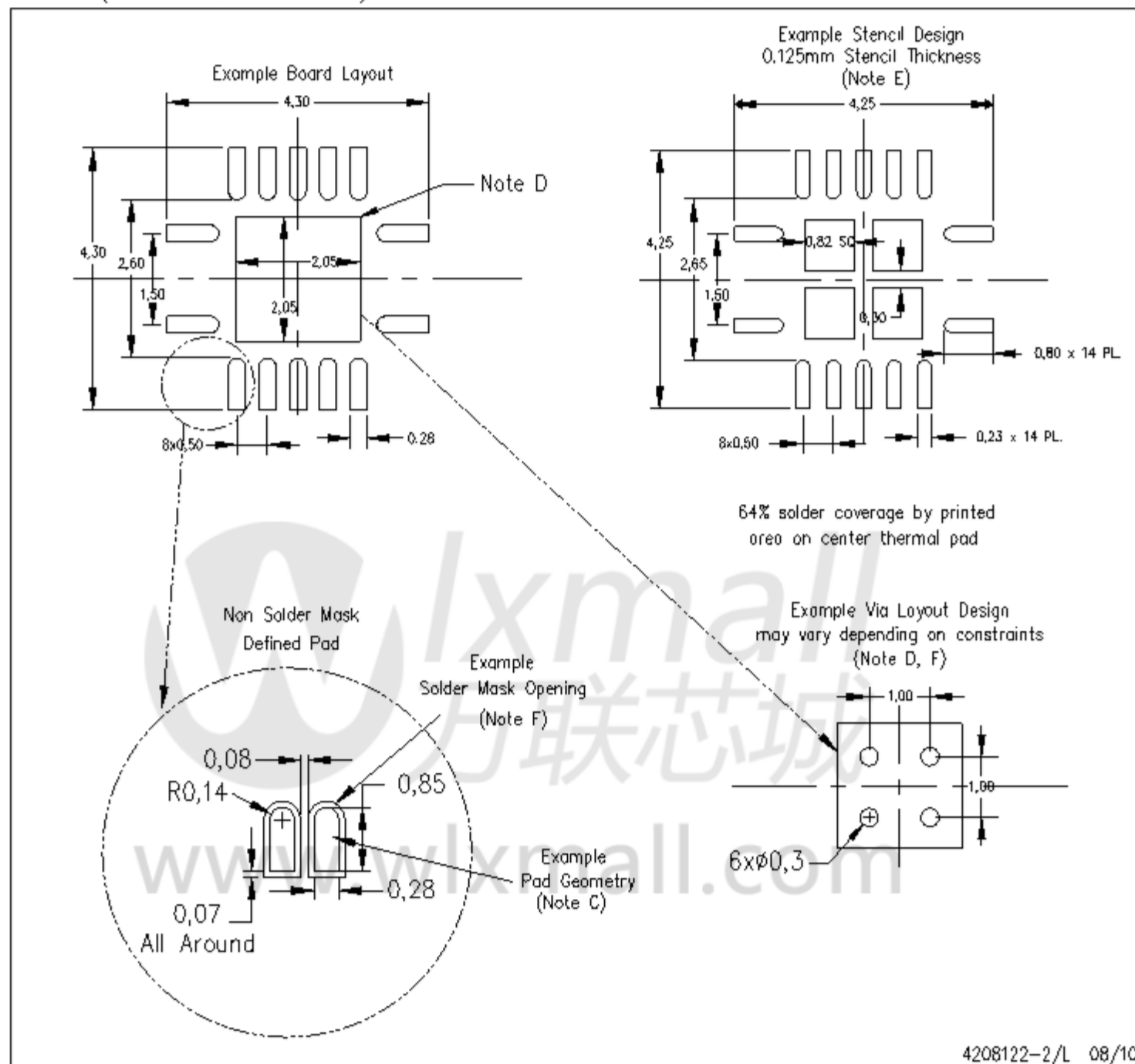
NOTES: All linear dimensions are in millimeters

Exposed Thermal Pad Dimensions

4206353-2/L 08/10

RGY (S-PVQFN-N14)

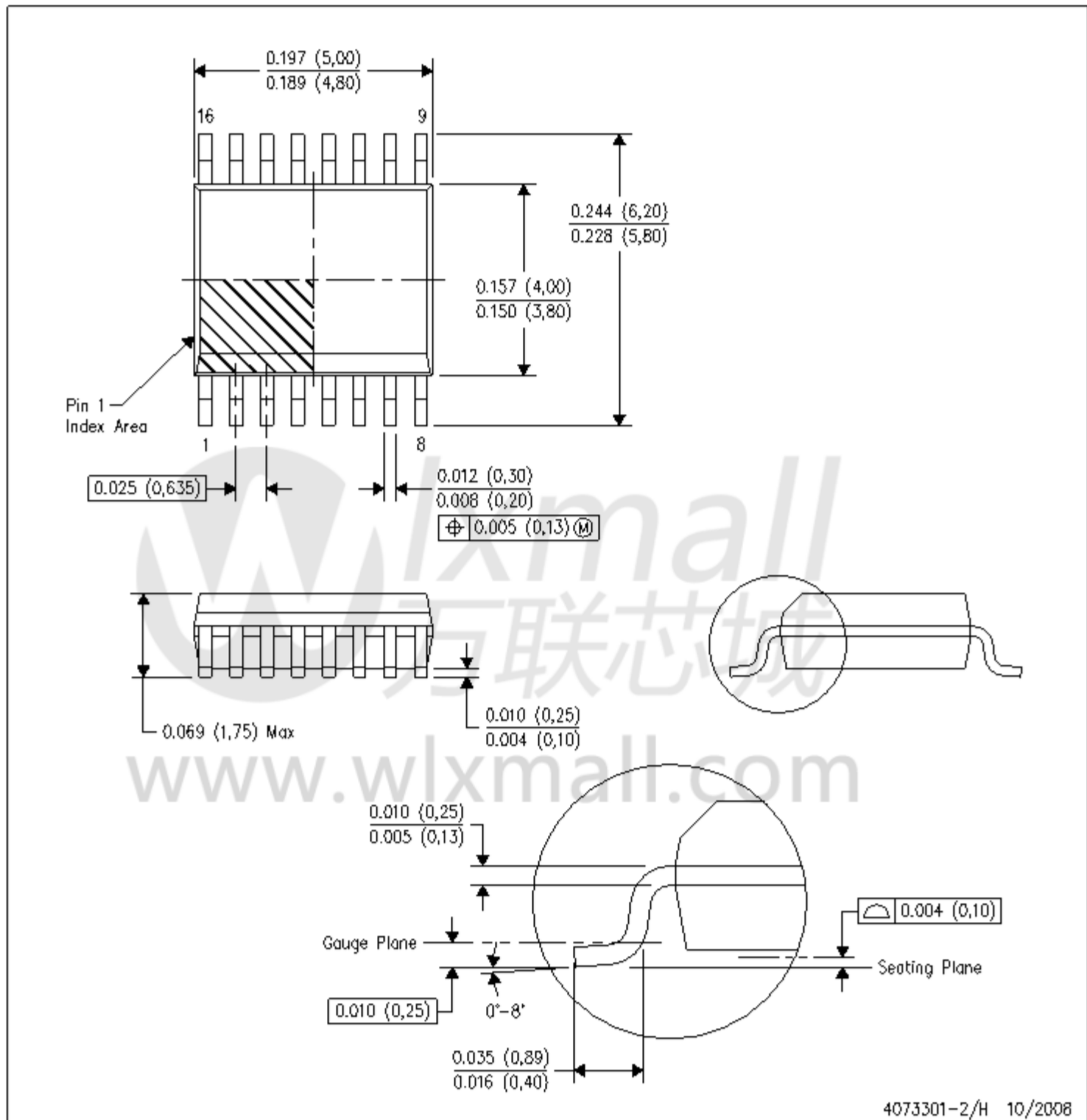
PLASTIC QUAD FLATPACK NO-LEAD



- NOTES:
- All linear dimensions are in millimeters.
 - This drawing is subject to change without notice.
 - Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs.
 - This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. Refer to Application Note, Quad Flat-Pack QFN/SON PCB Attachment, Texas Instruments Literature No. SLUA271, and also the Product Data Sheets for specific thermal information, via requirements, and recommended board layout. These documents are available at www.ti.com <<http://www.ti.com>>.
 - Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC 7525 for stencil design considerations.
 - Customers should contact their board fabrication site for minimum solder mask web tolerances between signal pads.

DBQ (R-PDSO-G16)

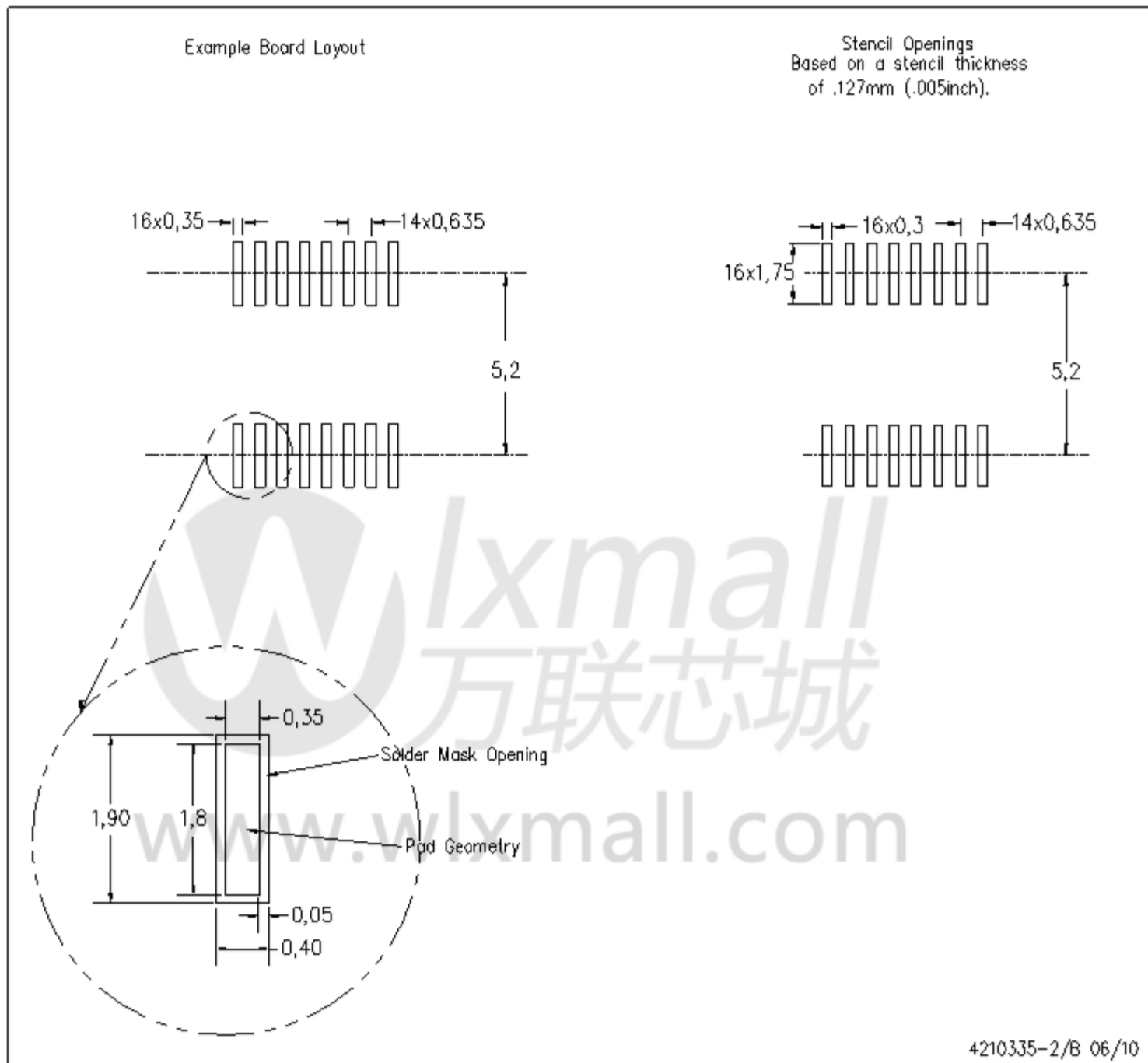
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE



- NOTES:
- All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - This drawing is subject to change without notice.
 - Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.006 (0,15) per side.
 - Falls within JEDEC MO-137 variation AB.

DBQ (R-PDSO-G16)

PLASTIC SMALL OUTLINE PACKAGE

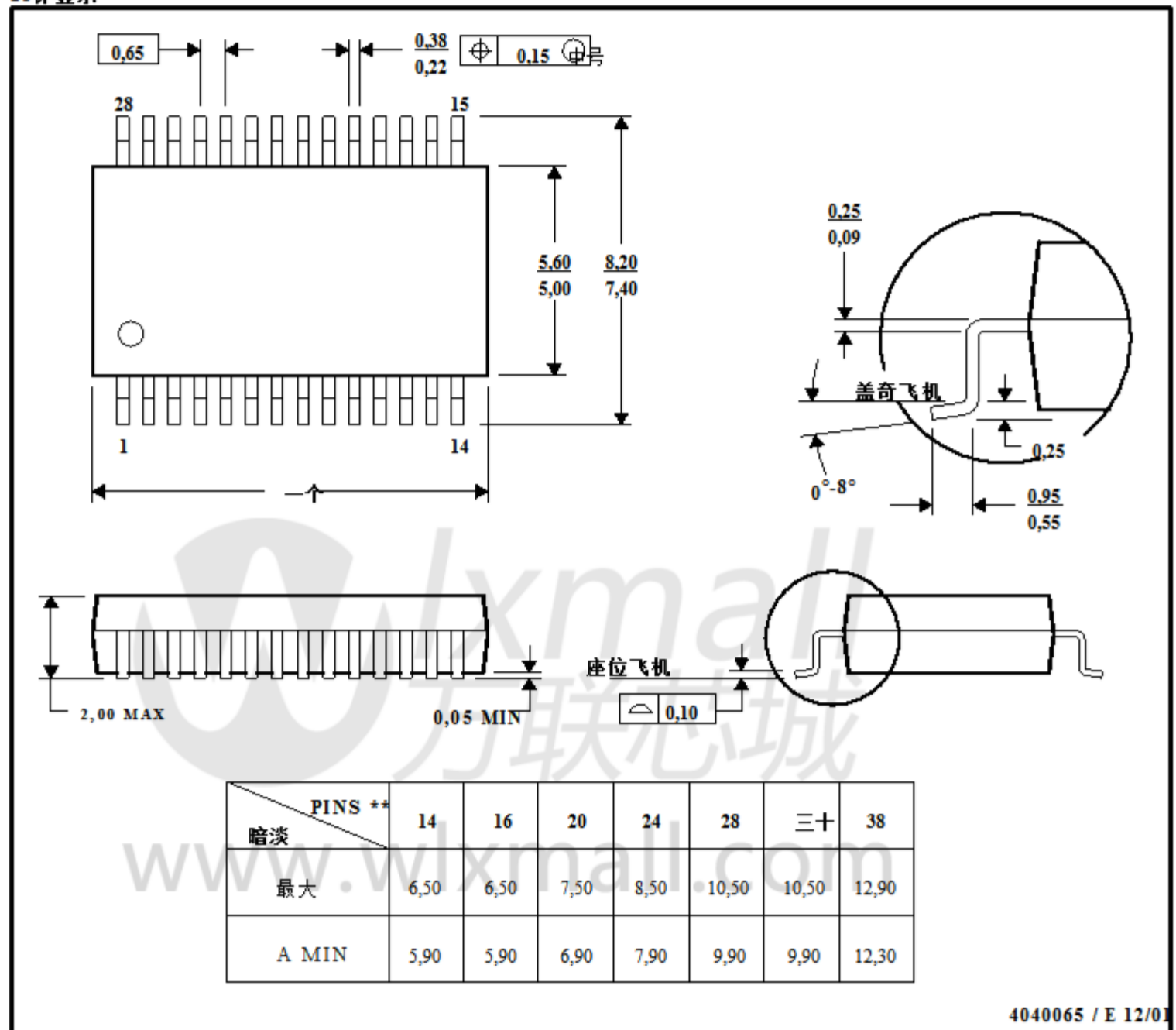


- NOTES:
- All linear dimensions are in millimeters.
 - This drawing is subject to change without notice.
 - Customers should place a note on the circuit board fabrication drawing not to alter the center solder mask defined pad.
 - Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs.
 - Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Example stencil design based on a 50% volumetric metal load solder paste. Refer to IPC-7525 for other stencil recommendations.

DB (R-PDSO-G **)

塑料小外形

28针显示

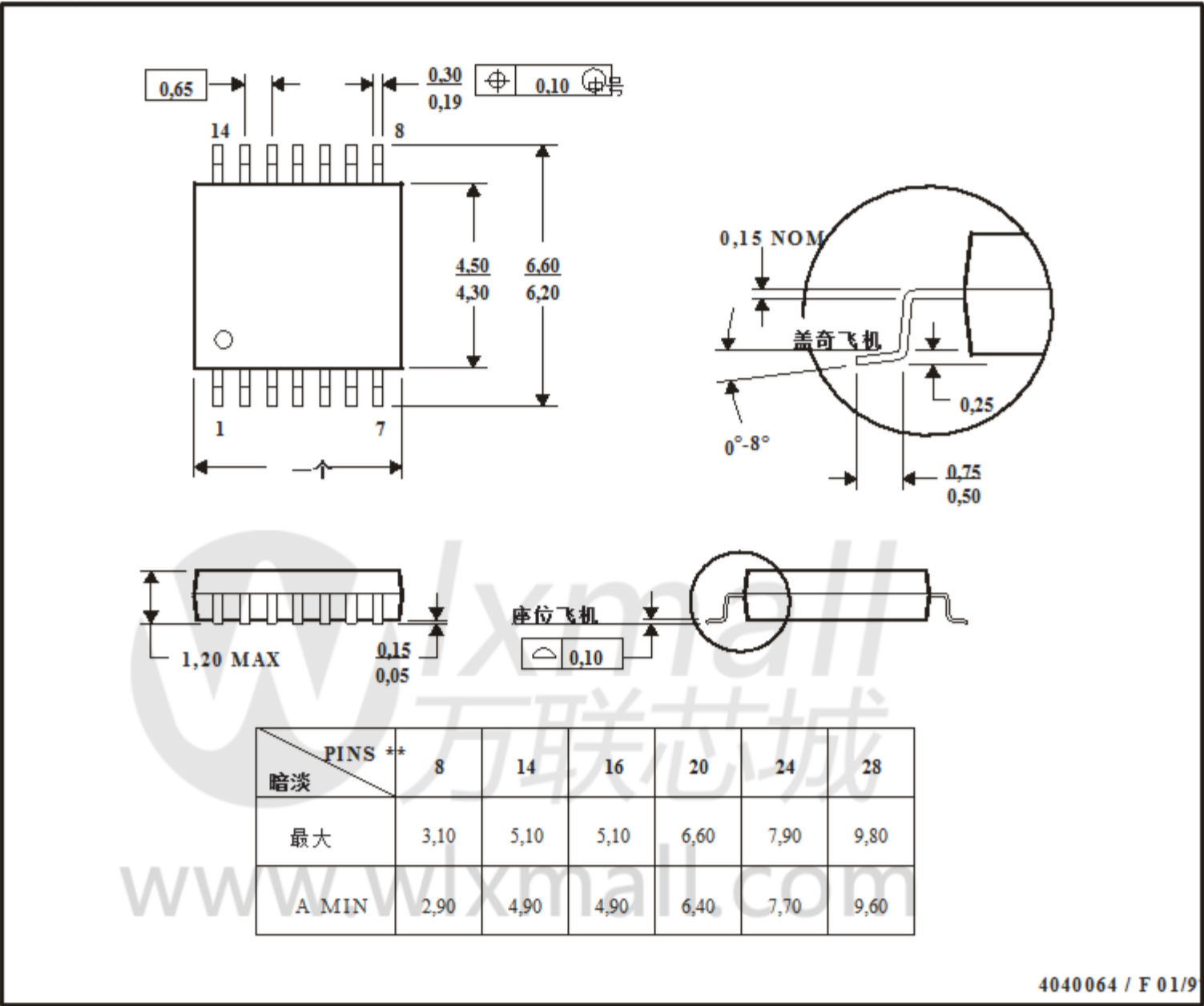


- 注意事项: A. 所有线性尺寸均以毫米为单位.
 B. 本图纸如有更改, 恕不另行通知.
 C. 本体尺寸不包括模具的闪光或突出不得超过0.15.
 D. 落在JEDEC MO-150内

PW (R-PDSO-G **)

塑料小外形包装

14针显示

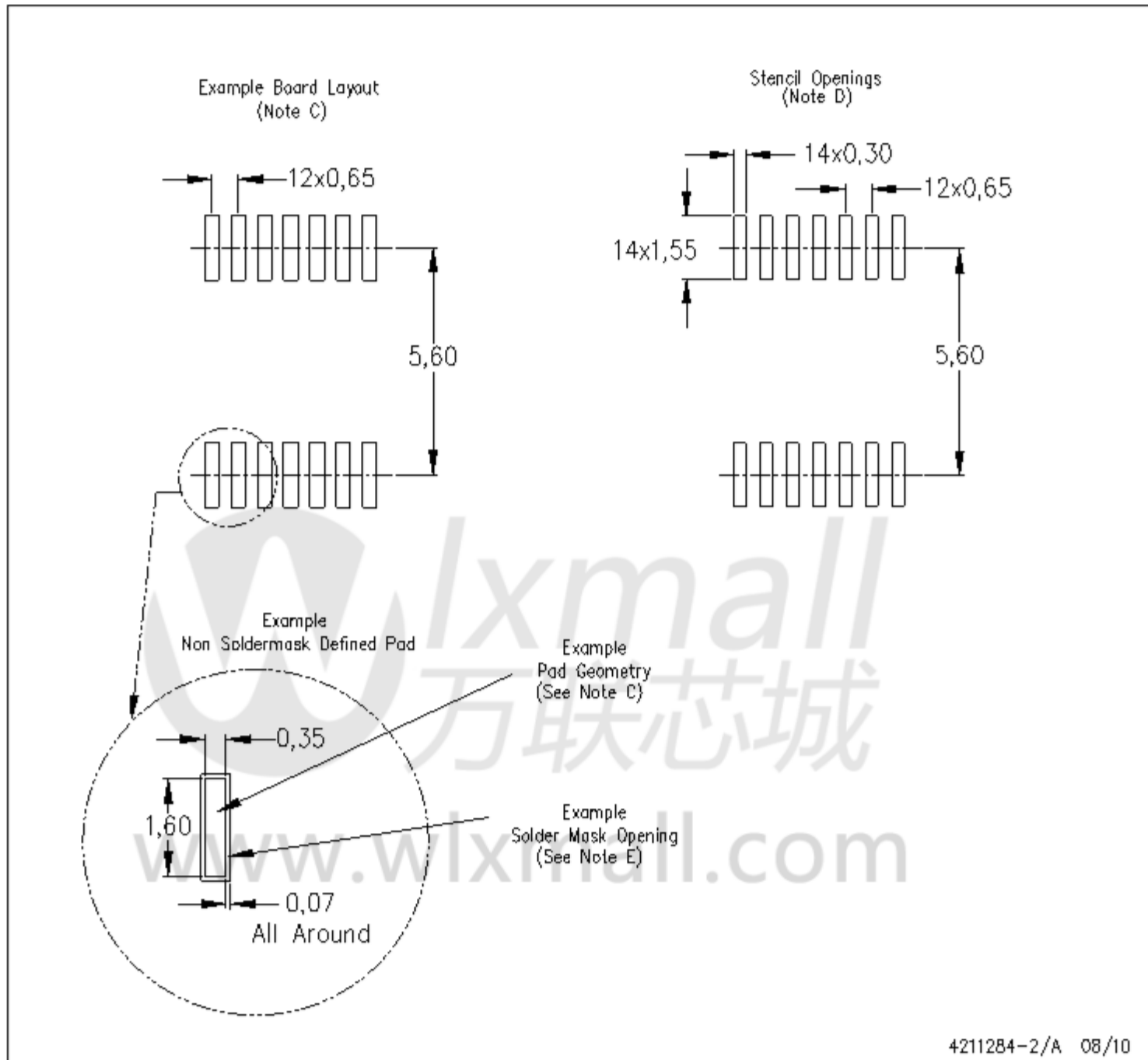


注意事项: A.所有线性尺寸均以毫米为单位.
B.本图纸如有更改,恕不另行通知.
C.本体尺寸不包括模具的闪光或突出不得超过0.15.
D.落在JEDEC MO-153内

4040064 / F 01/97

PW (R-PDSO-G14)

PLASTIC SMALL OUTLINE



- NOTES:
- All linear dimensions are in millimeters.
 - This drawing is subject to change without notice.
 - Publication IPC-7351 is recommended for alternate designs.
 - Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC-7525 for other stencil recommendations.
 - Customers should contact their board fabrication site for solder mask tolerances between and around signal pads.

重要的提醒

德州仪器 (TI) 及其子公司 (TI) 保留更正, 修改, 增强, 改进, 以及随时对其产品和服务进行的其他更改, 并在没有通知的情况下停止提供任何产品或服务. 客户应该在下订单之前获取最新的相关信息, 并应确认这些信息是最新的和完整的. 所有的产品都是根据 TI 在订单确认时提供的销售条款和条件进行销售.

根据 TI 标准, TI 保证其硬件产品的性能符合销售时适用的规格. 德州仪器认为有必要使用测试和其他质量控制技术来支持此保修. 除了在哪里由政府要求强制, 每个产品的所有参数的测试不一定执行.

TI 对于应用协助或客户产品设计不承担任何责任. 客户负责他们的产品和使用 TI 组件的应用. 为了最大限度地减少与客户产品和应用相关的风险, 客户应该提供适当的设计和操作保障.

TI 不保证或表示根据 TI 专利权, 版权, 掩盖作品的权利授予任何明示或暗示的许可, 或与使用 TI 产品或服务的任何组合, 机器或流程相关的其他 TI 知识产权. 信息由 TI 发布的关于第三方产品或服务的许可不构成 TI 使用此类产品或服务的许可. 保证或认可. 使用此类信息可能需要第三方根据专利或其他知识产权的许可. TI 第三方的财产或 TI 的专利或其他知识产权的许可.

TI 数据手册或数据手册中 TI 信息的复制只有在复制没有改变的情况下才允许. 所有相关的担保, 条件, 限制和通知. 通过改动来复制这些信息是不公平和欺骗性的商业惯例. TI 对此类更改的文档不承担任何责任. 第三方的信息可能会被附加限制.

TI 产品或服务的转售, 声明与 TI 针对该产品或服务所陈述的参数不同或超出其规定. 对相关 TI 产品或服务表示任何暗示的担保, 是不公平和欺骗性的商业行为. TI 不是对此类陈述负责或承担责任.

TI 产品未经授权用于 TI 产品故障合理的安全关键应用 (如生命支持). 预计会造成严重的人身伤害或死亡, 除非双方的官员已经签署了具体的协议. 这样的使用. 买方表示, 他们在应用程序的安全和监管方面拥有所有必要的专业知识. 承认并同意, 他们全权负责有关其产品的所有法律, 法规和安全相关要求. 以及在这些安全关键型应用中使用 TI 产品, 尽管有任何与应用相关的信息或支持. 由 TI 提供. 此外, 买方必须向 TI 及其代表全额赔偿因使用 TI 产品而引起的任何损害. 这样的安全关键应用.

除 TI 产品外, TI 产品既不设计也不适用于军事/航空应用或环境. TI 特别指定为军用级或“增强塑料”. 只有 TI 指定的军用级军品规格. 买方确认并同意, TI 未将其指定为军用级别的 TI 产品的任何使用仅限于此. 买方的风险, 而且他们全权负责遵守与这种使用有关的所有法律和监管要求.

除非特定的 TI 产品, TI 产品既不设计也不适用于汽车应用或环境. 由 TI 指定为符合 ISO / TS 16949 的要求. 买家承认并同意, 如果他们使用任何非指定的产品在汽车应用中, TI 不会对任何未能满足此类要求负责.

以下是可以获取其他德州仪器 (TI) 产品和应用解决方案信息的 URL:

制品	应用
放大器	amplifier.ti.com 音频 www.ti.com/audio
数据转换器	dataconverter.ti.com 汽车 www.ti.com/automotive
DLP®产品	www.dlp.com 通信和电信 www.ti.com/communications
DSP	dsp.ti.com 电脑和外设 www.ti.com/computers
时钟和定时器	www.ti.com/clocks 消费类电子产品 www.ti.com/consumer-apps
接口	interface.ti.com 能源 www.ti.com/energy
逻辑	logic.ti.com 产业 www.ti.com/industrial
电源管理	power.ti.com 医 www.ti.com/medical
微控制器	microcontroller.ti.com 安全 www.ti.com/security
RFID	www.ti-rfid.com 空间, 航空电子设备 & 防御 www.ti.com/space-avionics-defense
RF / IF 和 ZigBee®解决方案	www.ti.com/lprf 视频和影像 www.ti.com/video 无线 www.ti.com/wireless-apps